

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 登録実用新案公報(U)

(11) 実用新案登録番号

実用新案登録第3156734号  
(U3156734)

(45) 発行日 平成22年1月14日(2010. 1. 14)

(24) 登録日 平成21年12月16日(2009. 12. 16)

(51) Int. Cl. F 1  
H 0 1 L 33/00 (2010. 01) H 0 1 L 33/00 H

評価書の請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 8 頁)

<p>(21) 出願番号 実願2009-7719 (U2009-7719) (22) 出願日 平成21年10月29日(2009. 10. 29)</p>	<p>(73) 実用新案権者 509299215 柏友照明科技股▲フン▼有限公司 台湾桃園縣▲亀▼山郷科技二路37巷37 號 (74) 代理人 100108453 弁理士 村山 靖彦 (74) 代理人 100064908 弁理士 志賀 正武 (74) 代理人 100089037 弁理士 渡邊 隆 (74) 代理人 100110364 弁理士 実広 信哉 (72) 考案者 ▲呉▼ 朝欽 台湾台北市文山區興隆路二段244巷6號 2樓</p>
--	--

最終頁に続く

(54) 【考案の名称】 リフローによる半田付けの際にチップの回転防止が可能なLEDのパッケージ構造

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 リフローによる半田付けの際にチップの回転防止が可能なLEDのパッケージ構造を提供する。

【解決手段】 基板ユニット1、発光ユニット2、導電ユニットW及びパッケージユニット4を含む。基板ユニット1の基板本体10は、上表面にダイス載置領域11、正極導電はんだパッド11a、負極導電はんだパッド11bを有する。発光ユニット2は、基板本体10の上に位置決めされたLEDダイス20を有する。ダイス載置領域11の面積はLEDダイスの底面の面積より5~15%大きい。導電ユニットWの2本の導線Waは、LEDダイス20を正極導電はんだパッド11aと負極導電はんだパッド11bの間に電氣的に接続する。パッケージユニット4は基板本体10の上表面に成形して発光ユニット2と導電ユニットWを覆う透明パッケージコロイド40を有する。

【選択図】 図1A

